ZESTRON ACADEMY

TAGESPROGRAMM

AVT Tag für die Leistungselektronik

Dr. Markus Meier
Gruppenleiter Reliability & Surfaces
Zestron Europe

09.00 // Begrüßung
- Firmenpräsentation und Vorstellung des Tagesprogramms
- Vorstellungsrunde und spezifischer Fokus der Teilnehmer

Dipl.-Ing. Jörg Trodler
Technischer Berater in der AVT
Trodler-EAVT

09.30 // Materialien für Hochtemperaturanwendungen
- Einführungen die HT AVT
- Weichlotlegierungen, welche Legierung für welche Anwendung, Vor-und Nachteile
- Sintern als alternative AVT (würde ich gern einfügen, damit wir das zumindest anreißen)
- Diffusionslöten am Beispiel des BMBF - Projektes HotPowCon (HPC)
- Zusammenfassung und Ausblick

10.30 // Pause

Bastian Schlüter
Manager Produkt Management
Rogers GmbH

10.45 // Substratmaterialien für Leistungselektroniken
- Welche Keramik für welche Anwendung
- Übersicht zu den Metallisierungsvarianten und deren Einsatzgebieten
- Prozessfenster für die Verarbeitung

11.45 // Mittagspause

Dr. Paul Wild
Leiter Forschung & Entwicklung
Rehm Thermal Systems GmbH

12.45 // Reflow-Lötprozesse für die Leistungselektronik
- Einführung in Lötverfahren
- Löten mit Vakuumunterstützung
- Flussmittelfreies Löten

Simon Merkert
Head of Application
PINK GmbH Thermosysteme

13.45 // Batchlöten für Prototyping
- Verfahren
- Einsatz Aktivgas
- Plasmaaktivierung

14.45 // Pause

Dr. Hans-Georg von Ribbeck
Leiter Bondacademy und Forschungsprojekte
F & K Delvotec Bondtechnik GmbH

15.00 // Drahtbonden
- Überblick
- Historie
- Trends

Dr. Markus Meier

15.30 // Oberflächenanforderungen für die Leistungselektronik
- Sinterbarkeit, Bondbarkeit, Vergieß- bzw. Moldbarkeit
- Typische Ausfallmechanismen
- Möglichkeiten zur schnellen Qualitätsprüfung

Dr. Markus Meier

16.00 // Abschlussdiskussion
- Offene Fragen und Zusammenfassung
- Problemstellungen der Teilnehmer

16.30 // Ende der Veranstaltung